

华泰联合证券有限责任公司
关于苏州昀冢电子科技股份有限公司
2023 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：昀冢科技
保荐代表人姓名：钱亚明	联系电话：025-83387711
保荐代表人姓名：杜长庆	联系电话：025-83387762

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“昀冢科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，对昀冢科技进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告：

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

二、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下：

（一）业绩大幅下滑或亏损的风险

1、报告期内，消费电子和汽车电子业务销售收入同比略有增长，由于消费电子产品策略调整，毛利率同比略有下降。2023 年上半年，受行业影响，市场处于恢复期，盈利能力不及预期，但下半年开始消费电子市场呈现回暖趋势，加之光学摄像头领域市场空间的提升，下半年消费电子销售收入和毛利率优于上半年，呈向好趋势。

2、MLCC（片式多层陶瓷电容）业务进入研发及试产阶段，使得材料、人力、折旧等研发费用大幅增加，同时配套管理成本相应增加。

3、由于池州昀钡早期开拓市场阶段产品定价较低、产能利用率不足、固定费用占比较高导致毛利率偏低。

如果发生市场竞争加剧、宏观景气度下行、需求持续低迷、国家产业政策变化、公司不能有效拓展客户、公司无法继续维系与现有客户的合作关系等情形，且公司未能及时采取措施积极应对，将使公司面临一定的经营压力，存在业绩下滑的风险。

（二）核心竞争力风险

1、竞争加剧的风险

公司所处其他电子元件制造业产品众多，行业市场化程度较高，竞争较为激烈。尽管公司在精密零部件细分领域具有一定的技术、设备、客户、人才等优势，但下游产品技术迭代快，同行业竞争对手的技术水平也不断随之发展，如果公司在激烈的市场竞争中不能有效整合资源、及时开发新品、响应客户需求、提高产品质量，或者公司不能在现有产品领域及新应用领域进行有效的市场开拓，将面临市场份额下降及盈利能力下滑的风险。

2、终端用户产品升级的风险

公司产品客户定制化程度较高，受终端用户产品需求影响较大。终端用户的技术升级和产品迭代速度较快，这要求公司对于客户需求有准确、快速的把握，同时拥有较强的技术研发能力以实现产品的升级迭代，甚至先于客户需求判断行业趋势并提前进行新技术和新产品研发。如果公司在后续研发过程中对研发方向判断失误或研发进度缓慢，将面临无法满足终端用户技术升级及产品迭代需求，进而被竞争对手抢占市场份额的风险。

3、技术创新风险

随着手机光学领域终端产品不断向高像素、高响应度、小型化、轻量化方向发展，公司产品技术创新和开发的难度更高、综合性能更为全面，产品升级换代

速度更快。同时，为及时响应下游客户及终端用户的产品创新需求，公司需要具备快速响应下游客户需求乃至与客户协同研发的能力，这对技术创新和开发能力提出了更高的要求。如果公司无法及时跟上行业技术升级换代的步伐，公司产品竞争力将无法持续提升，盈利能力将受到影响。

4、技术人才流失及核心技术泄密的风险

作为精密电子零部件行业的高新技术企业，高素质的人才对公司未来的发展举足轻重。基于技术团队在精密电子零部件领域突出的技术能力，公司逐步建立起业内竞争优势。虽然正常的人才流动不会对公司的研发和经营造成重大不利影响，且公司与主要技术人员签署了竞业禁止协议，但如果主要技术人员大量流失，则可能对公司的研发和生产活动造成不利影响，进而影响公司经营业绩。

（三）经营风险

1、原材料价格波动的风险

公司生产经营采购的主要原材料包括塑料粒子、模具零件、金属、传感器及IC芯片、陶瓷薄片等。其中，塑料、金属类原材料属于大宗商品，其价格波动主要受宏观经济形势影响，传感器和IC芯片价格受下游行业周期和市场供需变化影响也较为明显。目前，公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，但若因市场供求变化、不可抗力等因素导致上述主要原材料采购价格发生大幅上升或原材料短缺，公司的盈利能力将可能受到不利影响。池州昀冢生产的MLCC产品，主要原材料和设备需要进口取得，相关生产设备采购金额较高，汇率波动对物料和设备的采购费用影响较大，可能对公司采购成本产生较大影响。

2、产品市场拓展的风险

公司在汽车领域形成销售，产销量呈现增长趋势。公司虽通过京西重工、万向精工、捷太格特、三井金属、拿森汽车、同驭汽车、东洋电装等汽车领域客户认证，并已获得汽车领域客户定点生产计划书，将按照客户备货计划生产和销售，但汽车类精密电子零部件产品普遍认证周期较长，可能存在产品认证周期中因终端客户战略调整导致终止认证的情况；除此之外，由于公司涉足汽车类精密电子零部件领域时间较短，在集成零部件产品上的研发经验相对较少，因此可能面临

集成汽车精密电子零部件拓展缓慢的情况，将会对公司未来业绩的增长造成不利影响。

公司未来在前述领域的产品销售收入存在一定的不确定性，如未来公司在汽车领域不能持续开拓新产品和客户，将无法在上述领域实现可持续增长，进而对公司未来业绩的增长造成不利影响。

3、产品价格下降的风险

随着手机光学领域终端产品不断向高像素、高响应度、小型化、轻量化方向发展，产品更新换代相对较快、既有的产品的平均单价在同系列新产品推出后将有所下降，以及下游客户对成本控制的日益加强、行业内竞争日趋激烈带来的价格竞争压力，使公司主要产品平均销售价格在报告期内总体降低，且不排除未来存在进一步下降的可能性，公司产品价格的下降可能对公司未来的经营业绩及财务状况造成不利影响。

4、直接客户及终端用户集中度较高的风险

公司直接客户主要为各大VCM马达厂商和CCM模组厂商，公司坚持的优质客户发展战略使得公司存在客户集中度较高的情况。目前，重点客户的销售订单对于公司的经营业绩有较大影响，如果该等客户的经营或财务状况出现不良变化，或者公司与其稳定的合作关系发生变动，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。

公司产品终端用户主要为华为、小米、VIVO、OPPO等手机终端厂商，报告期内，终端用户集中度也较高。如果未来公司产品质量、创新能力不能满足终端用户需求，可能对公司未来盈利能力造成不利影响。

5、经营规模扩张引致的管理风险

报告期内，公司业务规模和资产规模快速增长，与此相适应，公司建立了较为完善的法人治理结构和内部管理制度。上市后，随着募集资金的到位和新的投资项目的实施，经营规模的进一步扩大将要求公司在战略投资、运营管理、内部控制、募集资金管理等方面根据需要随时调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的

正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。

6、不能持续通过客户认证的风险

公司客户在引入新的供应商时，通常会进行供应商考察认证，通过认证的供应商方可进入其合格供应商资源池，客户才会与供应商建立正式商业合作关系。在首次取得客户认证后，客户会定期/不定期以稽核方式考察公司是否依然满足合格供应商的要求。因此，若公司不能持续获得重要客户的认证，将面临经营业绩增速放缓的风险。

7、内部控制风险

目前公司拥有5家全资或控股子公司，3家全资或控股孙公司。公司及各子公司建立了一系列内部控制制度对生产经营、投资决策进行管理。但随着公司及各子公司的生产、销售规模不断扩张，若公司及子公司内部控制制度不能得到有效执行，且公司对子公司约束机制不能得到严格执行，将可能导致管理失控、资产流失、经营亏损等问题，给公司的生产经营带来一定的内部控制风险。

（四）财务风险

1、应收账款坏账风险

2023年末，应收账款账面价值为21,470.37万元，占期末资产总额的比例为13.3%，较上年同期增加20.55%。1年以内的应收账款占应收账款总额的比例为98.79%。随着公司销售规模的持续扩大，应收账款规模相应增加。一方面，较大应收账款金额占用了公司的运营资金，影响资金周转效率,另一方面，若市场环境或客户运营状况发生风险因素，从而对公司应收账款会产生坏账风险，导致应收账款不能及时回收。

2、固定资产减值风险

2023年末，公司固定资产账面价值为65,219.65万元，占期末资产总额的比例为40.40%，公司固定资产规模较大，受产能利用率不足、工艺技术升级、日常保养等因素的影响，存在资产减值的风险。未来，若应用市场需求的重大变化、产品转型升级发生重大变革，或出现其他更为领先的工艺技术，导致公司固定资产

出现减值的风险。上述情况将对公司的经营业绩产生较大不利影响。

3、毛利率波动的风险

2023年营业毛利率为18.75%，较上年同期下降3.95个百分点，呈下降趋势。随着未来在应用领域不断拓展和深入以及行业内竞争格局的变化，将导致公司下游市场需求出现波动的可能。公司的技术创新能力、对产品更新迭代周期、供应链管理水平和因素都会影响毛利率，以上因素若发生重大变化，将对公司的产品毛利率产生较大的波动风险。

4、偿债压力和流动性风险

截至2023年12月31日，公司短期借款余额为4.58亿元，长期借款余额为5.51亿元，合并报表的资产负债率为81.50%，经营活动现金流净额持续为负，有一定的资金压力。未来如果公司的经营业绩和经营活动现金流量出现不利变化，或者与相关金融机构的合作关系出现不利变化，可能导致公司面临较大的偿债压力和流动性风险。

（五）行业风险

公司产品应用于智能手机、通讯、汽车电子等领域，业务发展可能会受到下游应用市场的影响。如果未来宏观经济形势发生剧烈波动，导致下游应用市场对公司产品需求减少，或电子信息产业政策发生重大不利变化，将在一定程度上限制公司的发展速度，可能对公司业务发展造成不利影响。

三、重大违规事项

2024年3月，昀冢科技、董事长兼总经理王宾和时任财务总监于红收到了中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的警示函，主要是针对公司收入确认不准确、在建工程核算不准确出具的警示函，公司及相关责任人已提交整改报告，除上述之外，不存在其他受到中国证监会及其派出机构行政处罚、交易所纪律处分或采取监管措施的情形。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

2023年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	524,895,545.60	463,062,007.76	13.35
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	515,371,613.96	457,330,219.73	12.69
归属于上市公司股东的净利润	-126,138,948.32	-68,116,472.46	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-130,931,700.75	-72,635,891.23	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-46,098,796.60	-44,257,279.55	不适用
归属于上市公司股东的净资产	339,131,867.23	447,395,530.08	-24.20
总资产	1,614,530,195.97	1,324,140,692.31	21.93
主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元/股）	-1.0512	-0.5676	不适用
稀释每股收益（元/股）	-1.0478	-0.5605	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-1.0911	-0.6053	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-31.92	-13.76	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-33.14	-14.68	不适用
研发投入占营业收入的比例（%）	20.28	16.74	增加3.54个百分点

1、报告期内，公司实现营业收入52,489.55万元，较上年同期上升13.35%，主要是公司受益于消费电子、汽车等下游行业复苏，终端市场景气度及需求上升，导致公司营业收入增加。

2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为-12,613.89万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,093.17万元，较上年度亏损扩大。本报告期内公司MLCC（片式多层陶瓷电容）业务仍处在研发及试产阶段，使得材料、人力、折旧等期间费用大幅增加。同时由于池州昀钲早期开拓市场阶段产品定价较低、产能利用率不足、固定费用占比较高导致毛利率偏低。

3、报告期末，公司总资产161,453.02万元，较期初上升21.93%，主要因为投资MLCC（片式多层陶瓷电容）项目而增加资产总额。

4、2023年基本每股收益为-1.0512元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为-1.0911元/股，主要系归属于上市公司股东的净利润为负所致。

五、核心竞争力的变化情况

1、核心技术优势及研发能力

(1) 公司具有从注塑、冲压、SMT封装、蚀刻、自动化监测等全产业链的技术要素能力，可自主开发复杂度高、精密度高的结构件，产品良率及精度均处于行业领先地位。

(2) 公司的模具设计能力和模具加工精度已经达到业内领先水平，零部件产品在结构性能等方面达到或超过日韩系同类厂商，具有市场竞争力。

(3) 公司拥有设备自主开发能力，除注塑机和回焊炉外，SMT产线的设备均是公司自主研发的，包括全自动点锡贴片机、全自动点胶机、机器视觉检测装置等。因此公司生产制造成本优势明显。

2、产品技术壁垒高，具有先发优势

CMI产品持续迭代创新，产品技术壁垒不断提高，在全球具有明显的先发优势。目前已开发CMI四代产品，且自CMI二代及以后的产品，目前国内及国外均无竞品，差异化竞争优势明显。

3、客户资源及信誉良好

(1) 公司注重产品质量管控及信用，产品交付率高。与行业头部公司如中蓝电子、舜宇光学、新思考、TDK等供应商建立了长期的合作关系。

(2) 通过自身对技术的深入理解，为客户提供定制化服务及方案设计等增值服务。与华为、OPPO等终端应用客户保持良好的研发及沟通关系。

未来，公司会持续提升产品技术壁垒，加大新产品及高毛利产品的销售占比，立足国内市场的同时加大海外市场的拓展。

4、研发实力优势

（1）先进的模具设计和制造技术

公司具备高水平的模具设计和制造技术，能够快速、准确地为客户设计出高品质的模具。同时，公司在制造过程中采用了先进的工艺和设备，保证了模具的高精度和稳定性，提高了产品的生产效率。

（2）先进的产品制造技术

公司拥有先进的注塑成型技术，能够实现高精度、高效率地生产各种注塑产品。同时硅胶成型技术以及双色成型技术的导入和运用，能够满足客户对不同产品类型的需求。在金属冲压和插入成型技术方面具有丰富的经验和实力，可以满足不同种类的插入成型产品的生产要求。在与CMI/CCMI产品密切相关的线圈绕制技术、高精度点胶技术、贴装技术、金属焊接技术、焊锡技术、信号测试技术等方面，随着经验和技术的不断积累，具有明显的技术优势。陶瓷基板制造技术方面，公司具有丰富的经验和实力，利用在电镀及化学镀膜，化学蚀刻，PVD（物理气相沉积），磁控溅射等领域的技术积累，能够生产出高品质、高可靠性的陶瓷基板以及热沉产品。

（3）设备研制的的能力

1) 设备精度高：公司在设备设计和制造过程中注重精度控制，采用高精度的加工设备和检测仪器，确保了设备的精度和稳定性。可以实现高精度点胶，高精度贴装，高精度焊接等机能。

2) 自主研发能力强：公司拥有一支专业的研发团队，具备强大的自主研发能力。注塑设备配套自动摆盘及视觉检测设备，CMI、CCMI产品生产组装产线等设备全部为自行设计、制造，大大提高产品的技术竞争力。

3) 设备灵活性高：公司的设备具有较强的灵活性，可以快速适应不同的生产需求和市场变化。公司可以根据产品特点和生产要求，对设备进行模块化设计，实现设备的多功能性和可定制性。这使得公司能够快速响应市场变化，满足客户对产品多样化和个性化的需求。

4) 设备智能化程度高：公司不断引进和采用先进的自动化设备，通过智能化改造和升级，提高了设备的自动化和智能化程度。这不仅提高了生产效率，还

降低了人工成本，保证了产品质量的稳定性和一致性。

(4) 技术优势

公司的技术优势主要体现在以下几个方面：

1) 自主研发能力：公司具备强大的自主研发能力，能够自主设计、开发各种满足客户需求的产品。特别是在注塑产品、CMI/CCMI产品、陶瓷基板产品方面，公司拥有一支高素质的研发团队，具备丰富的技术经验和创新能力，能够不断推出具有竞争力的新产品。

2) 先进的生产工艺：公司在注塑、冲压、插入成型、CMI产品相关的胶水、焊锡、焊接、金属/非金属表面处理、镀膜工艺等方面具有领先的工艺运用和技术优势，同时，公司不断引进新技术、新工艺，提高生产效率和产品质量，为客户提供高品质的产品。

3) 严格的质量控制：公司注重质量控制，从原材料采购、生产过程到成品检验，都严格执行质量标准和质量控制流程。这保证了产品的稳定性和可靠性，提高了客户对公司的信任度。

4) 丰富的产品线：公司拥有丰富的产品线，从塑胶产品，CMI产品到陶瓷基板，天线类产品以及MLCC被动元件产品，涵盖了多种类型的电子元器件和相关产品。这使得公司产品能够满足不同客户的需求，为客户提供完整的产品解决方案，提高与客户的合作深度与广度。

5、人才优势

精密模具的设计和制造、电子零部件产品的加工需要从业人员具有丰富的行业经验，并不是简单的人才叠加或者机器系统集成。公司历来重视研发团队的维护和培养，并持续不断地加大研发投入和完善研发体制。公司目前已经形成稳定的研发梯队，公司的核心技术人员均拥有十年以上行业内知名企业的从业经验。除了保持初创团队的稳定性外，公司还持续发展壮大技术人才队伍。

公司已建立了一支从技术研发、生产管理到市场销售各方面配置完备、各具优势、协同互补、架构稳定的管理团队，核心管理人员拥有丰富的从业经验，具

备专业的技术和管理能力。通过在公司长时间的管理经验沉淀，公司管理团队具备了对发展趋势的研判能力，有助于推动公司业务全面快速发展。

公司的技术积累、成本管控、高效生产、客户维护和市场开拓等离不开研发、采购、生产和销售等各个岗位人才的付出，已经形成了成熟和稳定的业务模式。

上述竞争优势是公司多年经营积累的成果，随着业务规模的扩大和融资渠道的拓宽，上述竞争优势将被深化，具有可持续性。

综上所述，2023年度，公司核心竞争力未发生不利变化。

六、研发支出变化及研发进展

2023年公司持续加大开发投入，研发实力不断增强，创新成果丰硕。2023年，公司研发投入10,642.94万元，研发投入同比增加37.32%。

截至2023年12月31日，公司共计获得现行有效的专利授权265项，其中发明专利42项，实用新型专利223项，另获得软件著作权12项。报告期内，公司新增专利58项，其中发明专利14项，实用新型44项。

随着行业内公司对研发技术人才的需求快速扩大，研发技术人才缺口日益凸显。为满足长期发展需求，报告期内，公司在保持高比例的研发投入外，还进一步扩大研发团队，补充关键研发能力，维护核心竞争力。报告期内，公司大力拓展人才招聘，汇聚优秀人才。截至报告期末，公司研发人员增加12人，同比增长7.06%；报告期末公司研发人员占员工总数的比例为16.88%。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致

公司于2021年8月30日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目的议案》《关于投资片式多层陶瓷电容器项目的议案》《关于投资半导体中高端引线框架生产项目的议案》：

(1) 汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目

为满足在汽车电子和电子陶瓷领域不断增长的订单需求，公司的全资子公司

池州昀豕拟投资建设汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目，项目总投资为29,953.28万元，项目分三期投资，第一期计划投资为16,823.97万元，第二期计划投资为7,377.41万元，第三期计划投资为5,751.90万元。汽车电子精密零部件项目目前处于建设装修阶段，电子陶瓷基板项目已经开始投入生产使用。

（2）片式多层陶瓷基板项目

为了扩充公司类半导体领域中电子陶瓷的产品品类，并满足公司在MLCC领域的订单需求，提升公司市场地位，池州昀豕拟投资建设片式多层陶瓷电容器项目，项目总投资为112,435.73万元，项目分两期投资，第一期计划投资为62,479.64万元，第二期计划投资为49,956.09万元。本项目拟对建筑面积为7,953.69平方米的厂房进行装修，以达到片式多层陶瓷电容器生产所需的高标准洁净度要求；同时拟对建设面积22,826.37平方米普通洁净度及普通厂房进行装修。该项目的厂房工程、装修工程、配套设施已完成，符合片式多层陶瓷电容器产品所需的生产环境标准，生产设备已经到厂并完成安装试机工作，报告期内片式多层陶瓷电容器开始试产运行。

（3）半导体中高端引线框架生产项目

为了增强公司的市场竞争力和后续发展，并推动公司在半导体引线框架市场的开拓，控股孙公司池州昀豕拟投资半导体中高端引线框架生产项目，项目总投资为10,150万元，项目分两期投资，第一期计划投资为5,020万元，第二期计划投资为5,130万元。本投资项目按计划正常推进中，目前处于运行阶段。2023年7月建成蚀刻生产线和电镀产线并投产使用，建设完成的半导体中高端引线框架生产线基本达到设计产能。

八、募集资金的使用情况及是否合规

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州昀豕电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]606号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限公司采用向社会公开发行方式，向社会

公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币9.63元,共计募集资金人民币288,900,000.00元,扣除发行费用40,890,319.81元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币248,009,680.19元,上述款项于2021年3月29日到账。

上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天衡验字(2021)00035号《验资报告》。

(二) 本年度使用金额及当前余额情况

截至2023年12月31日,公司已使用募集资金248,921,255.68元,其中2021年使用222,839,738.31元,2022年使用26,081,514.51元,2023年使用2.86元,募集资金余额为60.85元,详见下表:

币种:人民币 单位:元

募集资金专户摘要	金额
截至2022年12月31日止专户余额	2.86
募集资金专户资金的增加项	
(1)利息收入扣除手续费净额	60.85
募集资金专户资金的减少项	
(1)销户资金划转基本户	2.86
截至2023年12月31日止专户余额	60.85

截至2023年12月31日,募集资金余额为60.85元(为累计收到的银行存款利息)。

(三) 募集资金管理情况

截至2023年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

募集资金存储银行名称	银行账号	储蓄方式	期末余额(元)	备注
招商银行股份有限公司 苏州园区支行	512908897010102	活期存款	-	已销户
中信银行昆山支行	8112001013900584756	活期存款	-	已销户
宁波银行股份有限公司 昆山支行	75090122000337678	活期存款	60.85	

募集资金存储银行名称	银行账号	储蓄方式	期末余额 (元)	备注
中国民生银行股份有限公司苏州分行	632694669	活期存款	0	已销户
合 计	/	/	60.85	

(四) 募投项目先期投入及置换情况

2023年1月-12月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年1月-12月，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(七) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(八) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2023年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(九) 节余募集资金使用情况

2023年1月-12月，鉴于相关募投项目募集资金已使用完毕，公司注销中信银行昆山支行募集资金专户，并将节余募集资金2.86元补充流动资金。

综上所述，昀冢科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2023年12月31日，昀冢科技不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

2023年，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接持股及变动情况如下表：

单位：股

姓名	职务	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因
王宾	董事长、总经理、核心技术人员	13,183,740	13,183,740	0	-
刘文柏	董事、核心技术人员	0	0	0	-
诸渊臻	董事、核心技术人员	0	0	0	-
莫凑全	董事、核心技术人员	0	0	0	-
翁莹	董事	0	0	0	-
方浩	董事	2,126,340	2,076,340	-50,000	二级市场减持
董炳和	独立董事	0	0	0	-
刘海燕	独立董事	0	0	0	-
钟佳珍	监事	0	0	0	-
王清静	职工监事	2,126,340	1,595,301	-531,039	二级市场减持
方银霞	监事	0	0	0	-
陈艳	财务总监、董事会秘书	0	0	0	-
朱璜	独立董事（离任）	0	0	0	-
甘子英	监事会主席（离任）	2,126,340	3,192,680	1,066,340	二级市场增持
于红	财务总监（离任）	0	0	0	-
王胜男	董事会秘书（离任）	0	0	0	-
谌龙模	核心技术人员	0	0	0	-
曹瑞武	独立董事	0	0	0	-
合计	/	19,562,760	20,048,061	485,301	/

截至2023年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持股情况如下表：

姓名	职务	直接股东名称	直接股东持有公司股份数量	在直接股东中的持股比例	间接持有公司股份股数
王宾	董事长、总经理、核心技术人员	苏州昀一	8,505,450	55.53%	4,722,651
		苏州昀二	10,206,630	85.10%	8,686,240
		苏州昀三	10,206,630	93.08%	9,500,668
		苏州昀四	9,781,290	84.06%	8,221,810
刘文柏	董事、核心技术人员	苏州昀一	8,505,450	5.25%	446,536
诸渊臻	董事、核心技术人员	苏州昀四	9,781,290	1.74%	170,106
莫湊全	董事、核心技术人员	苏州昀二	10,206,630	1.46%	148,843
方银霞	监事	苏州昀一	8,505,450	1.65%	140,340
甘子英	监事会主席（离任）	苏州昀四	9,781,290	2.73%	266,648
于红	财务总监（离任）	苏州昀三	10,206,630	0.25%	25,517
谌龙模	核心技术人员	苏州昀一	8,505,450	3.75%	318,954

2023年内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持有的公司股票未发生增减变动。

截至2023年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的股份不存在质押、冻结的情况。

十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

（一）2023 年度公司业绩持续亏损

2023 年度，公司实现营业收入 52,489.55 万元，较上年同期上升 13.35%，公司实现的净利润为-13,803.85 万元，较上年度亏损扩大，公司亏损主要是由于以下原因：

1、公司消费电子业务一方面在 2023 年上半年，受行业影响，市场处于恢复期，盈利能力不及预期，另一方面公司产品策略调整，公司自主研发的 CMI 一代、CMI 二代、CMI 三代、CMI 四代等系列产品同步面向市场开发拓展，在巩固高端机型市场的同时，加大中低端机型的市场应用，不断提高市场渗透率，销售产品结构的调整导致 CMI 件毛利率下降，带动公司整体毛利率下降。

2、MLCC（片式多层陶瓷电容）业务于 2023 年第四季度正式量产，MLCC 相关工程项目本期在建工程转固金额 44,250.30 万元，导致新增折旧金额较大。

3、半导体引线框架业务处于成长期，相应的固定费用和新增工艺投入的资源仍在持续增加。

保荐机构关注公司业绩亏损的原因，以及相关影响因素的持续性。

在消费电子业务方面，一方面消费电子市场自 2023 年下半年以来有所复苏，另一方面，2024 年度公司将重点推进 CMI 三代及四代产品在高端旗舰机的使用量，特别是潜望式及可变式光圈的市场应用，以进一步提高市场竞争力和盈利能力；与此同时，依托自动化制造及规模量产的成本优势，积极拓展中低端终端手机的应用，从而进一步扩大 CMI 系列产品的市场空间。在 MLCC 业务方面，公司 MLCC 产品于 2023 年第四季度正式量产。在半导体引线框架业务方面，考虑到半导体引线框架业务在行业赛道及客户资源上与公司所从事的消费电子领域协同性相对较低，公司拟收缩对半导体引线框架业务的持续投入，2024 年第一次临时股东大会已审议通过，待池州昀钿半导体材料有限公司增资交易完成以后，池州昀钿将不再纳入公司合并报表范围内，减少对公司财务状况的影响。

（二）公司招股说明书中披露的部分经营风险出现重大不利进展

公司招股说明书中披露了“公司业绩存在可能无法持续增长的风险”、“偿债压力和流动性风险”等主要经营风险。

2023年度，公司实现的净利润为-13,803.85万元，较上年度亏损扩大。一方面近年来，消费电子行业景气度不高，市场竞争激烈，公司不断开发新产品以应对下游市场的降价压力，毛利率存在一定幅度的下降；另一方面，公司投资的 MLCC 业务、半导体引线框架业务处于早期发展阶段，固定费用和新增投入资源较大，导致产生亏损。

2023年度，公司资产负债率为81.50%，资产负债率较高主要是公司发展 MLCC 业务、半导体引线框架业务持续需要资金投入，2023年度新增了较多的长期借款所致。公司的流动比率为0.68，速动比率为0.55，处于较低水平，主要是公司为了满足业务发展的资金需求增加了短期借款所致。


未来，保荐机构将继续督促公司采取切实措施应对外部环境和市场情况的变化，践行“提质增效重回报”行动方案，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示经营风险，切实保护投资者利益。同时，本保荐机构提请投资者特别关注相关事项带来的风险。

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人:



钱亚明



杜长庆

华泰联合证券有限责任公司

2024年 5月 10日

